

T19-Oxford PECVD 注意事項

○材料限制如下：

儀器名稱	英文名稱	材料 (2007/08/28 更新)	
		可進的材料	不可進的材料
電漿輔助 化學氣相 沉積系統	Oxford PECVD	(1) Si, Ge, SiOx, SiNx (2) NDL Metal-PVD 沈積之金屬薄膜 (Ti,TiN,Ni,Co,Al-Si-Cu(Cu<1%), Al,..) (3) NDL MOCVD 及工研院 ALD 沈積之 High-k 薄膜 非以上(1), (2), (3)類之試片, 僅接受 委託代工	(1) Cu, Au, Ag, Fe, Pt, (2) 試片的薄膜為開放 Cu, Au, Ag, Fe, Pt 薄膜沈積製程之設備所鍍 (如 NDL ULVAC Sputter、交大奈 米中心 VTI E/B Gun Coater、Ion Tech Sputter 等)

○預約的時段 15 分鐘內仍未到者，則其他在現場等候人員可以直接使用機台。

○此 Oxford PECVD 屬後段機台，故在此機台沈積完薄膜後，**嚴禁**再進前段製程機台

○**嚴禁**貼認何種類的**膠帶**

○如果需要其他製程條件，請與機台工程師討論

○遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知**緊急應變指揮中心**
協助處理(分機 7761& 7762)。